

# 2026年3月期中間期 決算説明

株式会社フェローテック

1. 当期連結決算においては、連結子会社は2025年1月～2025年6月末の業績を連結しております。
2. 本資料は、2026年3月期中間決算の業績に関する情報の提供を目的としたものであり、当社株式の購入や売却等を勧誘するものではありません。投資に関する決定は、利用者ご自身のご判断において行われるようお願いいたします。
3. 本資料は開示日現在のデータに基づいて作成されております。本資料に記載された意見や予測等は、資料作成時点の当社の判断であり予告なしに変更されることがあります。

FerroTec

## 業績

- 2026年3月期中間期の売上高は1,410億円、営業利益は143億円、当期純利益63億円
- 2026年3月通期予想は、売上高2,850億円、営業利益300億円、当期純利益160億円

## マレーシア投資等

- マレーシア・クリム第1工場は稼働本格化、第2工場は6月起工し2026年下期竣工予定
- ジョホール（パワー基板）稼働開始、熊本（洗浄）・石川第3（セラミックス）が竣工

## 顧客動向・戦略

- 米国顧客のEx-Chinaニーズに対応、顧客の期待が高く、将来成長にも貢献
- 中国内の半導体投資・生産需要は活発、中国内設備活用し、成長を追求

## 株主還元他

- 株主還元強化、DOE採用（下限を3.5%）、配当金は通期148円予定
- 中国上場志向先のIPOおよびグループ資産の売却（500億円）等は継続検討

## トピックス① Ex-China対応（マレーシア）

### ▶ 今後の欧米顧客向け量産拠点として、基盤づくりを推進

マレーシア・クリム第1工場



- 量産開始後、順調に生産量増加、稼働率向上を果たす  
想定よりも早く単月黒字化を達成した
- 今後、認証をさらに進め顧客への供給力を向上させると  
ともに、新規顧客獲得も目指す

マレーシア・クリム第2工場



- 6月の起工から基礎工事を終え、建屋工事へ移行  
12月には棟上式を予定している
- 2026年下期の竣工に向けて予定通り進捗している



## トピックス② Ex-China対応（日本）

- 「日本回帰」－ 日本での製造拠点づくり（石川第3工場、熊本工場）が今期完了
- 欧米および日本顧客の需要取り込みをさらに加速させていく

### 石川第3工場

セラミックス



製造品目	ファインセラミックス、マシナブルセラミックス
工場面積	建屋面積：13,000㎡（敷地面積：30,000㎡）
主要設備	焼成炉／熱処理炉／マシニングセンター／洗浄設備／三次元測定機、画像測定機 （クリーンルームクラス：10000／1000）

### 熊本工場

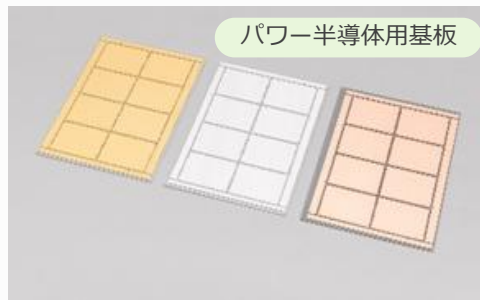
装置部品洗浄



製造品目	半導体製造装置及びこれらの部品等の再生・精密部品再生 洗浄サービス事業等
工場面積	建屋面積：13,000㎡、（敷地面積：30,000㎡）
主要設備	PVD・CVD・エッチング装置部品再生洗浄設備／プラズマ溶射機 ／アーク溶射機／超音波顕微鏡、三次元測定機 （クリーンルームクラス：100）

## トピックス③ 中国子会社の動向（上場子会社関連）

### FTSVA – FLHの子会社化を完了



上場市場 深圳証券取引所創業板  
証券略称 富乐德 (乐は楽の簡体字)  
証券番号 301297

- 中国上場子会社（部品洗浄）である安徽富樂德科技發展股份有限公司（FTSVA）による、パワー半導体用基板製造子会社である江蘇富樂華半導体科技股份有限公司(FLH)の株式交換による子会社化を完了
- パワー半導体用基板開発等を目的とした約7.8億元（161億円）の第三者割当増資も実施

### CCMC – 株式店頭登録・取引開始



上場市場 新三板（全国中小企業株式譲渡システム）  
証券略称 中欣晶圆  
証券番号 874810

- 半導体ウエーハ事業の持分法適用会社である杭州中欣晶圆半導体股份有限公司（CCMC）株式が中国の店頭取引市場である中国新三板（全国中小企業株式譲渡システム）で店頭登録され、10/22より取引開始
- 同時に新三板を通じて、固定資産購入や有利子負債返済等を目的とする6.1億元（約129億円）の第三者割当増資も実施

1. 連結決算サマリ
2. 連結貸借対照表・キャッシュフロー
3. 2026年3月期 通期業績予想
4. 中期経営計画

# 1. 連結決算サマリ

---

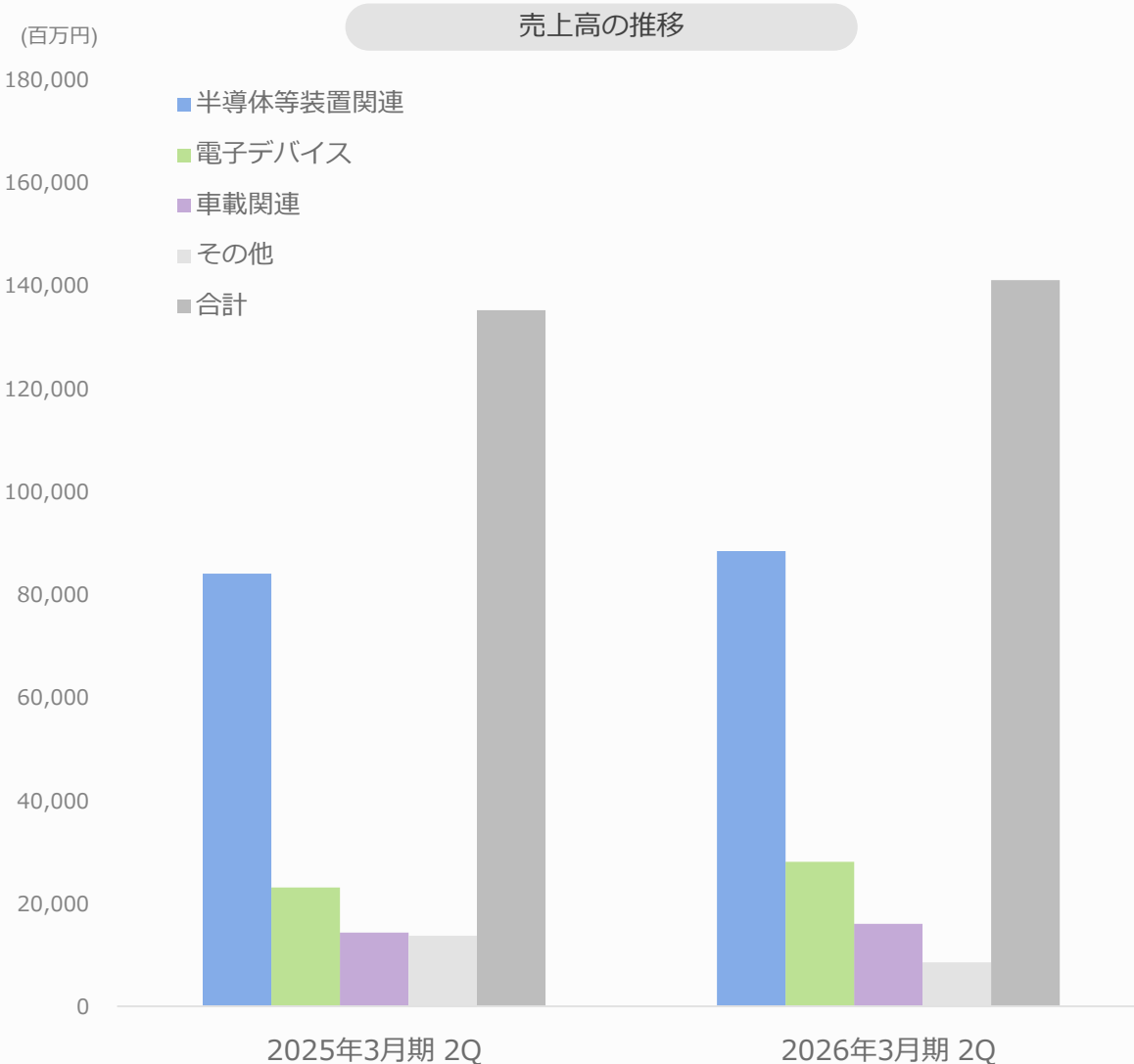
# 連結決算サマリ

(百万円)		2025年3月期 2Q	2026年3月期 2Q	前年同期比		主な要因
		金額	金額	金額	増減率	
売上高		135,157	140,980	5,823	4.3%	● 半導体等装置関連ではセラミックスおよび洗浄事業の売上増加が貢献 電子デバイスの光通信モジュール向けサーモモジュールの成長継続がグループ業績を牽引
売上原価		97,046	100,200	3,154	3.3%	
売上総利益		38,111	40,780	2,669	7.0%	
販売管理費		23,859	26,446	2,587	10.8%	● 人件費や新工場立上げコスト負担等のため、営業利益は横ばい
営業利益		14,251	14,333	81	0.6%	
営業外収益		5,324	4,010	-1,313	-24.7%	
営業外費用		4,105	5,420	1,314	32.0%	● 為替差損益悪化20億円（差益減少7.4億円、差損増加12.6億円）に加え補助金収入の減少6.3億円等により、経常利益は減益
経常利益		15,470	12,923	-2,546	-16.5%	
特別利益		5	-	-5	-	
特別損失		-	493	493	-	● 関西工場から石川工場への製造の移管・集中により固定資産処分損を計上
非支配株主に帰属する当期純利益		2,228	1,895	-333	-15.0%	
親会社株主に帰属する当期純利益		9,190	6,308	-2,881	-31.4%	
設備投資額※		22,882	27,376	4,493	19.6%	● パワー半導体用基板 11億円 シリコンパーツ+坩堝 5億円 装置部品洗浄 6億円
減価償却費		11,241	13,249	2,008	17.9%	
為替レート（期中平均）	米ドル	154.06	147.48			
	人民元	21.25	20.34			

※設備投資額は、有形固定資産および無形固定資産の取得額の合計



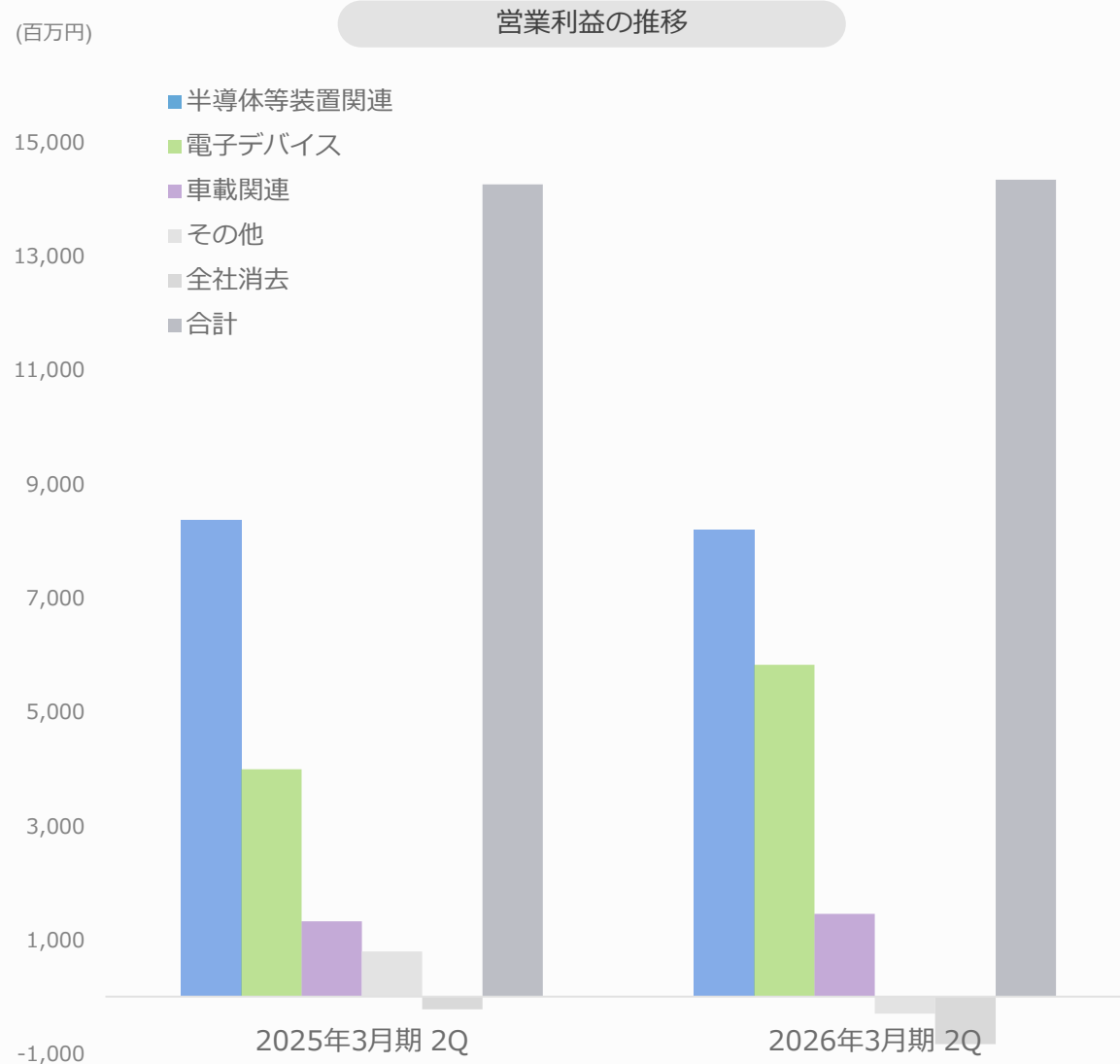
# セグメント別 売上高



- ▶ 半導体製造装置・半導体・FPD工場の稼働が好調、堅調な需要を受け増収
- ▶ EV市況の変化を受け、車載関連は伸び悩む

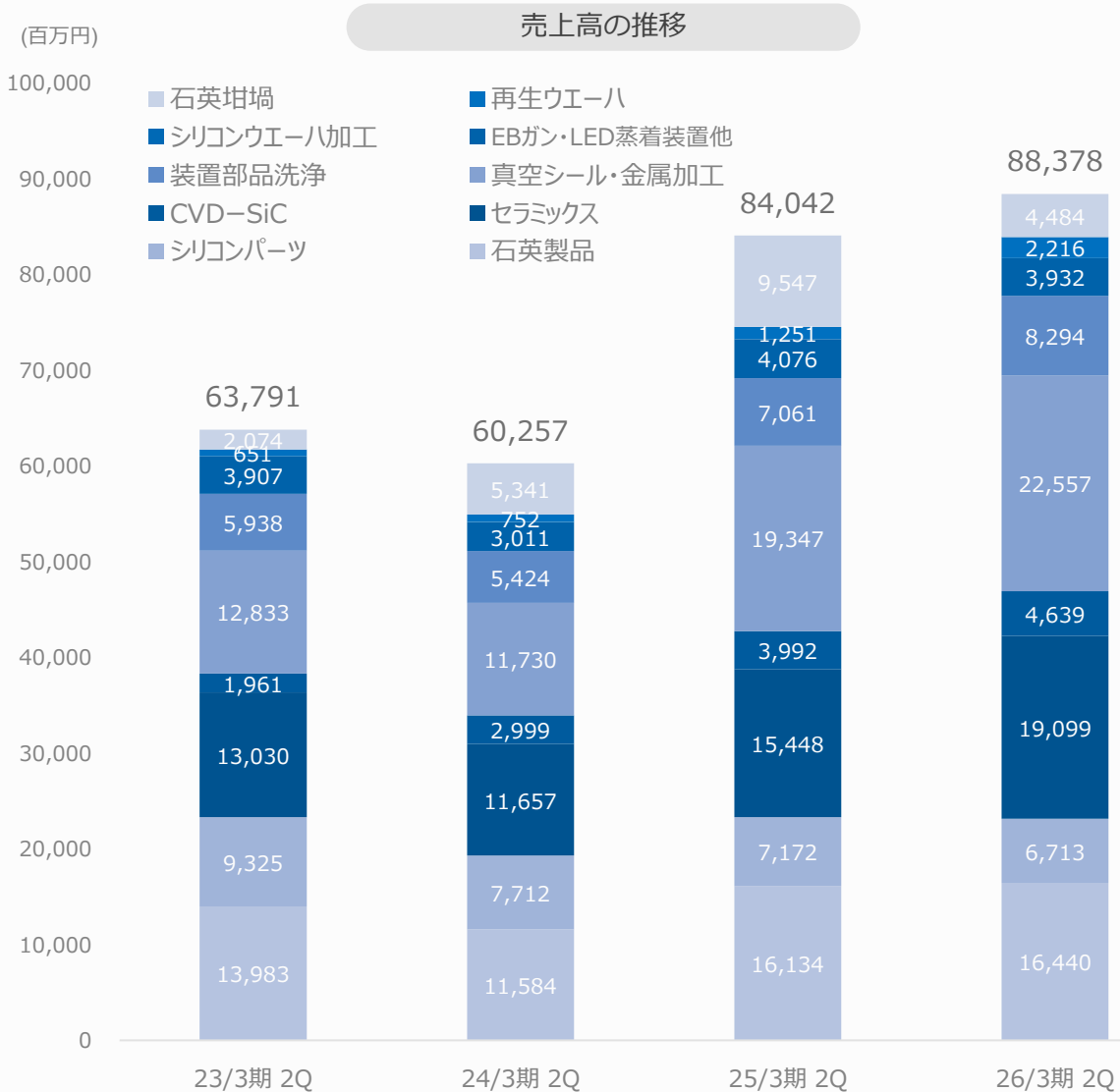
売上高（百万円）	2025年3月期 2Q		2026年3月期 2Q		前年同期比	
	金額	構成比	金額	構成比	金額	増減率
半導体等装置関連	84,042	62.2%	88,378	62.7%	4,335	5.2%
電子デバイス	23,085	17.1%	28,090	19.9%	5,004	21.7%
車載関連	14,304	10.6%	15,991	11.3%	1,686	11.8%
その他	13,723	10.2%	8,520	6.0%	-5,202	-37.9%
合計	135,157	100.0%	140,980	100.0%	5,823	4.3%

# セグメント別 営業利益



## 減価償却費や新工場の立ち上げ費用が利益を圧縮

営業利益（百万円）	2025年3月期 2Q		2026年3月期 2Q		前年同期比	
	金額	利益率	金額	利益率	金額	増減率
半導体等装置関連	8,363	10.0%	8,190	9.3%	-172	-2.1%
電子デバイス	3,992	17.3%	5,823	20.7%	1,830	45.9%
車載関連	1,323	9.3%	1,454	9.1%	130	9.9%
その他	793	5.8%	-301	-	-1,094	-138.0%
全社消去	-220	-	-833	-	-613	278.0%
合計	14,251	10.5%	14,333	10.2%	81	0.6%



## セグメント総括

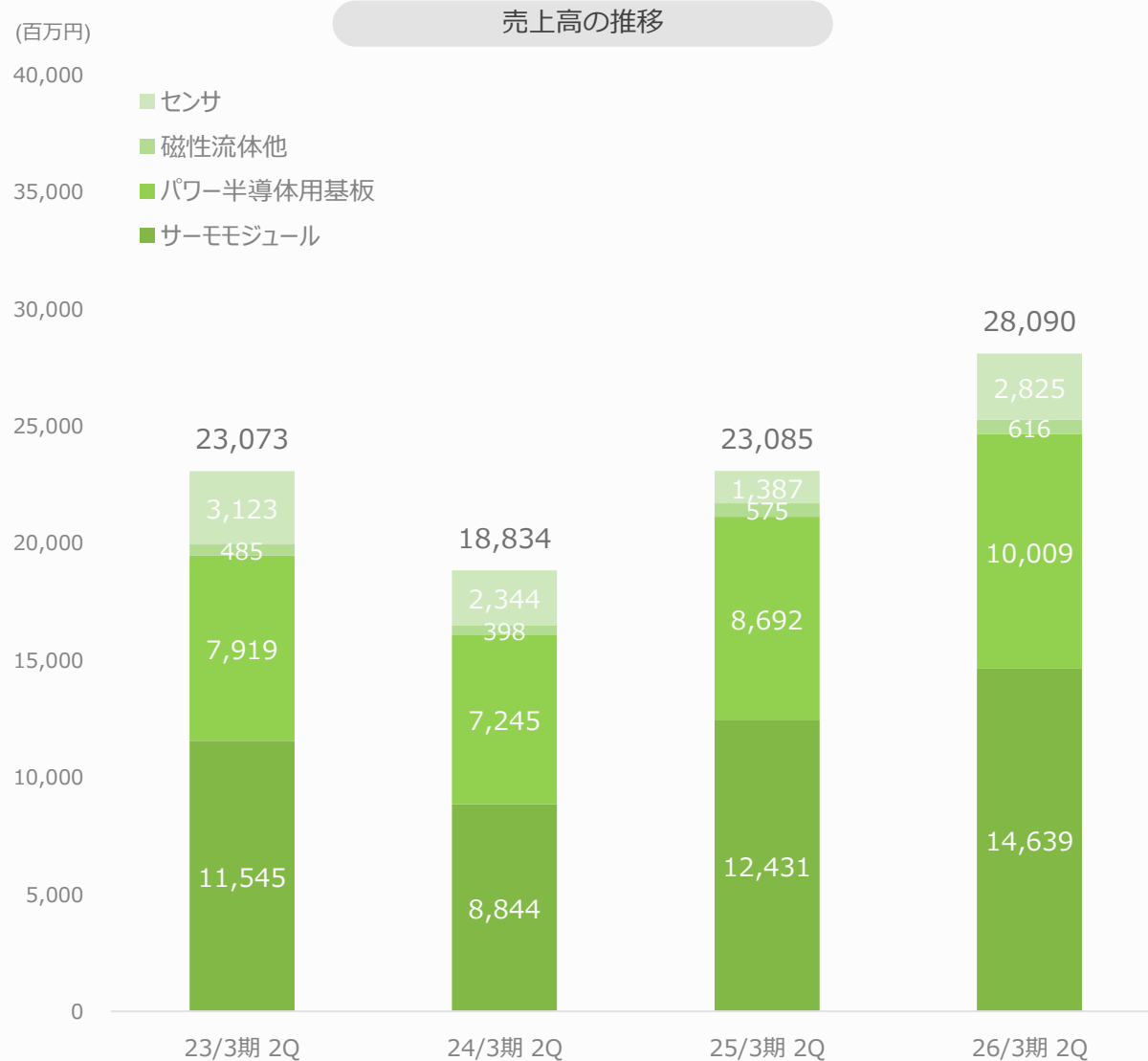
- ▶ 半導体マテリアル製品のセラミックスが業績を牽引、石英・シリコンパーツは在庫影響あり
- ▶ 部品洗浄事業は成長継続、石英坩堝はPV向け売上減少も損益は改善

## 製品別詳細

石英坩堝	PV向け縮小し半導体向けに注力、収益性が改善
再生ウエーハ	中国で拡大する需要取込みが順調に進捗、増進
装置部品洗浄	中国における需要が増勢、着実な需要取込みで成長
真空シール・金属加工	米国、中国での金属加工需要は堅調、引合い増加、成長継続

## 半導体マテリアル

セラミックス	米国、中国の需要を着実に取込み増勢、グループ業績に貢献
CVD-SiC	特定の当社製品の需要が落込み伸び悩み
シリコンパーツ	顧客在庫の影響等から売上軟調、コスト削減・収益改善中
石英製品	顧客在庫の影響が残存、売上伸び悩み



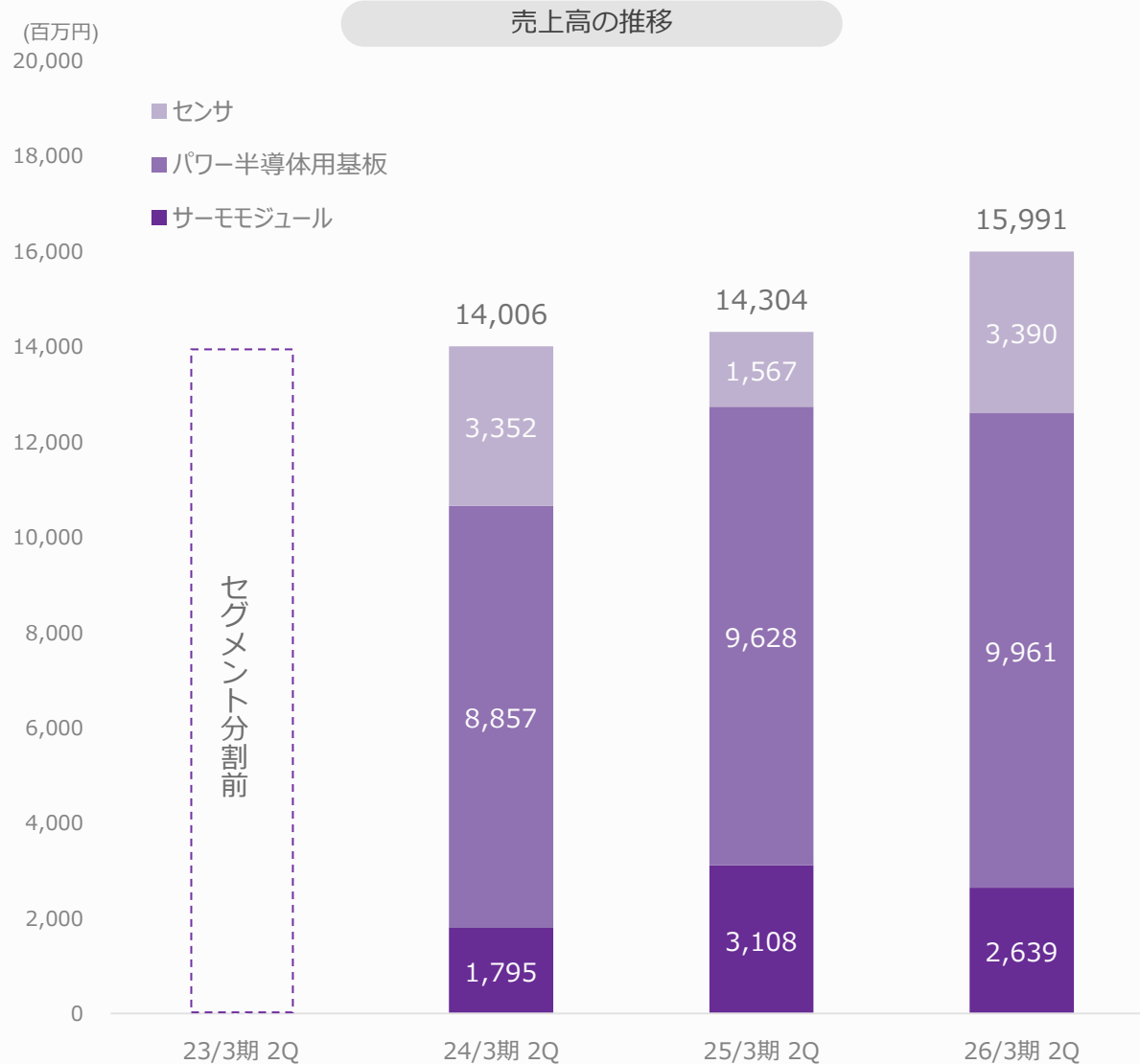
## セグメント総括

- ▶ 好調な生成AIサーバ投資を背景に、光トランシーバー向けが増加し、サーモモジュールの業績伸長、当社業績を牽引
- ▶ センサは大泉製作所の決算期変更により、前年度は1Qの売上計上がなく前年同期比で増加

## 製品別詳細

- |          |   |
|----------|---|
| サーモモジュール | <ul style="list-style-type: none"> <li>生成AI需要を受け光トランシーバー向けの出荷が増加業績伸長し、当社業績を牽引</li> </ul>              |
| パワー半導体基板 | <ul style="list-style-type: none"> <li>足許需要が伸び悩み競争激化するなか、前年同期並みの売上増加を確保</li> </ul>                    |
| センサ      | <ul style="list-style-type: none"> <li>大泉製作所の決算期変更により前年度1Q計上なく前年同期比で増加</li> <li>エアコン向け等が貢献</li> </ul> |





## セグメント総括

- ▶ EV需要の成長が鈍化、車載向けパワー半導体用基板の売上は横ばい
- ▶ 市況悪化の影響もあり、サーモモジュール売上は前年同期比減少

## 製品別詳細

- |          |  |
|----------|--|
| サーモモジュール | <ul style="list-style-type: none"> <li>市況悪化の影響もあり、温調シート向け等の売上が減少<br/>前年同期比売上減少</li> </ul>    |
| パワー半導体基板 | <ul style="list-style-type: none"> <li>EV需要の成長が鈍化、需要低調の中で価格競争も激化<br/>売上は前年同期並みを確保</li> </ul> |
| センサ      | <ul style="list-style-type: none"> <li>大泉製作所の決算期変更により前年度1Q計上なく<br/>前年同期比で増加</li> </ul>       |

## 2. 連結貸借対照表・キャッシュフロー

---

# 資産の部 – 連結貸借対照表

(百万円)	25/3期 期末	26/3期 9月末	増減額	主な要因
流動資産	295,367	296,468	1,101	
現金及び預金	117,727	115,700	-2,027	6割程度は、洗浄、パワー半導体用基板、麗水センサ等の外部出資がある会社、洗浄の増資資金等が増加
受取手形及び売掛金	92,608	88,909	-3,698	
たな卸資産	72,078	77,119	5,040	売上増加に伴い、半導体マテリアルの在庫が増加
固定資産	305,226	303,095	-2,131	
有形固定資産	245,064	242,351	-2,712	25/3期 9月末（子会社は6月末）換算レートが25/3期期末比で円高となり、減少 他、25/3期 期末比の増減要因
建物及び建築物	90,505	95,224	4,719	
機械装置及び運搬具	87,549	83,039	-4,509	旧FTHD（熊本工場／部品洗浄） + 23億円
工具、器具及び備品	8,637	8,360	-276	旧FTMT（石川第3工場／セラミックス等） + 28億円
土地	4,669	4,671	1	マレーシア（パワー基板） + 22億円
リース資産（純額）	14,852	13,757	-1,095	常山4期（金属加工） + 23億円
建設仮勘定	38,850	37,299	-1,551	
無形固定資産	6,166	5,496	-669	
のれん	1,861	1,769	-92	
投資その他資産	53,996	55,247	1,250	
資産合計	600,593	599,563	-1,029	

# 負債および純資産の部 – 連結貸借対照表

(百万円)	25/3期 期末	26/3期 9月末	増減額	主な要因
流動負債	151,750	<b>150,376</b>	-1,374	26/3期 9月末残高 短期借入 + 1年内長期借入・社債 656億円 長期借入金 + 社債 1,141億円 有利子負債合計 1,797億円 支払債務の減少は、決済条件変更等なくスポット要因
支払手形、買掛金及び電子記録債務	59,592	<b>52,602</b>	-6,990	
短期借入金	34,482	<b>37,255</b>	2,773	
1年以内返済長期借入金および1年以内償還社債	24,592	<b>28,400</b>	3,807	
固定負債	125,292	<b>135,616</b>	10,323	
社債	-	<b>6,288</b>	6,288	
転換社債型新株予約券付社債	25,000	<b>25,000</b>	-	
長期借入金	78,222	<b>82,806</b>	4,583	
負債合計	277,043	<b>285,993</b>	8,949	
純資産	323,549	<b>313,570</b>	-9,979	25/3期 期末比の増減要因 内、為替換算調整勘定 (25/3期 期末比で円高のため) -180億円
株主資本	188,595	<b>191,195</b>	2,600	
その他包括利益累計額	48,235	<b>30,536</b>	-17,698	
非支配株主持分	86,718	<b>90,860</b>	4,141	
負債・純資産合計	600,593	<b>599,563</b>	-1,029	26/3期 9月末残高 パワー半導体 308億円 シリコンパーツ・坩堝 176億円 部品洗浄 237億円
自己資本比率	39.4%	<b>37.0%</b>	-2.3P	
為替レート（期末日）	米ドル	158.18	<b>144.81</b>	
人民币	人民币元	21.67	<b>20.19</b>	



# キャッシュフロー計算書

(百万円)	2025年3月期 2Q	2026年3月期 2Q	主な要因
営業活動によるキャッシュフロー	4,151	12,405	
税金等調整前四半期純利益	15,475	12,430	
減価償却費	11,241	13,249	マレーシア・クリムや常山（セラミックス）等で増加
為替差損益（-益）	-417	826	
売上債権の増減（-増）	-17,544	-4,162	旧FTHD（熊本工場／部品洗浄等） 26億円
たな資産の増減（-減）	-5,963	-9,354	旧FTMT（石川第3工場／セラミックス等） 45億円
仕入債務の増減（-減）	4,400	-1,096	常山（セラミックス） 24億円
持分法による投資損益（-益）	2,560	2,263	マレーシア（パワー基板） 20億円
その他	-5,601	-1,751	常山4期（金属加工） 21億円
投資活動によるキャッシュフロー	-17,736	-32,596	
有形固定資産の取得による支出	-22,781	-27,225	マレーシア・クリム（石英・セラ・金属） 24億円
無形固定資産の取得による支出	-101	-150	麗水（センサ） 22億円
投資有価証券の取得による支出	-1,107	-752	
その他	6,253	-5,028	関係会社（CCMC）株式の追加取得 41億円
財務活動によるキャッシュフロー	12,169	25,061	
短期借入金の増減額	4,192	4,333	
長期借入による収入	20,031	24,681	主に当社（FTJ）による調達
長期借入金の返済による支出	-8,888	-13,739	
社債の償還による支出	-3,423	-320	
転換社債型新株予約権の発行による支出	-	-	
非支配株主からの払込による収入	2,997	14,653	洗浄子会社（FTSVA）の増資
その他	-2,741	-4,546	
現金及び現金同等物の増加額	7,562	-596	
現金及び現金同等物の期首残高	96,806	108,899	
現金及び現金同等物の期末残高	104,368	108,302	

## 3. 2026年3月期 通期業績予想

---

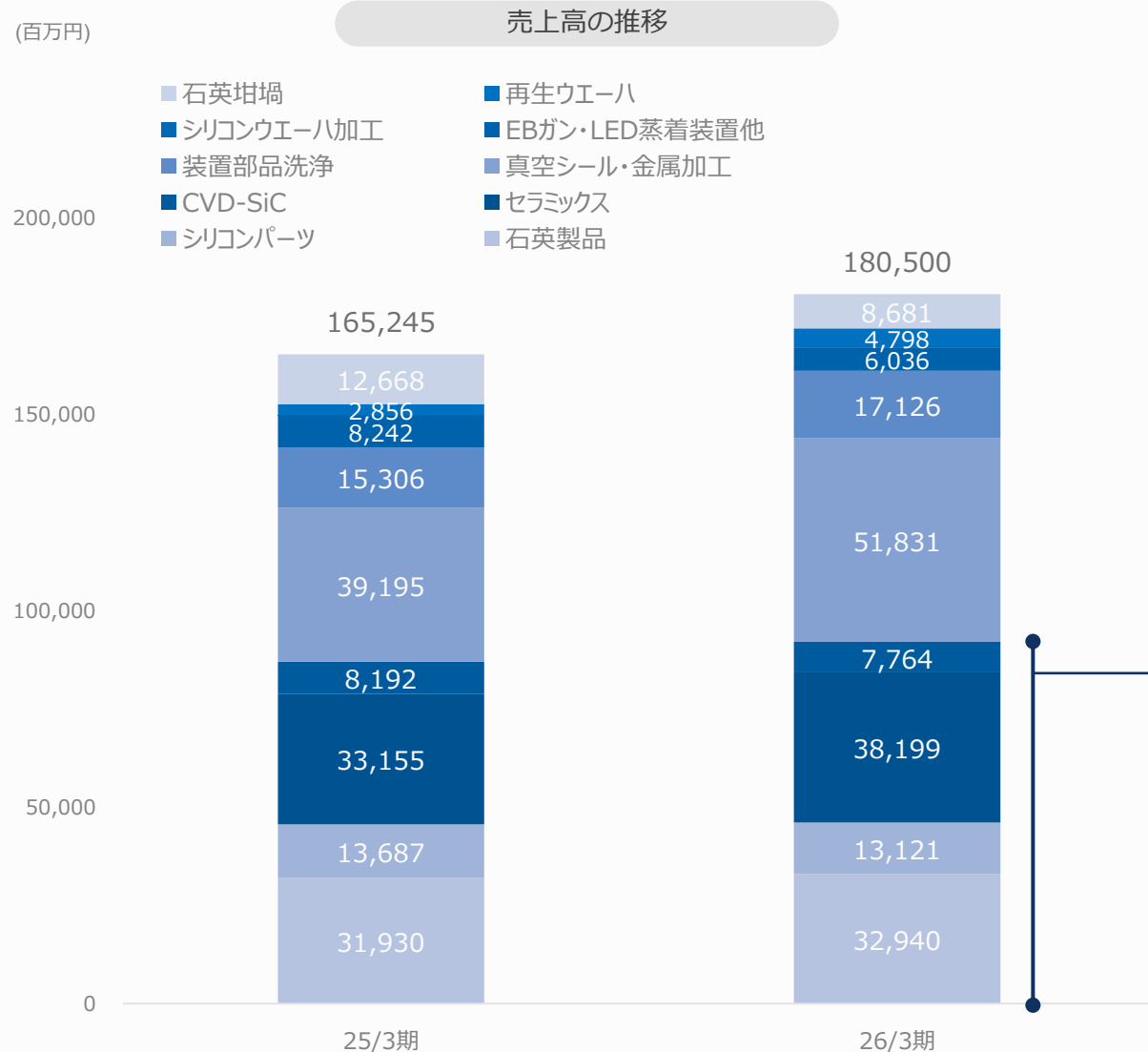
# 2026年3月期 通期業績予想

▶ 半導体装置関連事業等の足許業績を反映し、営業利益および経常利益を上方修正

(百万円)	2025年3月期 期末		2026年3月期 期末		前年同期比
	実績	期初予想	修正予想	期初対修正比	
売上高	274,390	285,000	<b>285,000</b>	0.0%	3.9%
営業利益	24,089	28,000	<b>30,000</b>	7.1%	24.5%
経常利益	25,558	26,000	<b>28,000</b>	7.7%	9.6%
親会社株主に帰属する当期純利益	15,692	16,000	<b>16,000</b>	0.0%	2.0%
設備投資額※	51,776	65,000	<b>65,000</b>	0.0%	25.5%
減価償却費	23,672	27,000	<b>27,000</b>	0.0%	14.1%
EBITDA	47,761	55,000	<b>55,000</b>	0.0%	15.2%
為替レート（期中平均）	米ドル	152.24	146	<b>148</b>	
	人民元	21.12	20	<b>20</b>	

※設備投資額は、有形固定資産および無形固定資産の取得額の合計

# 半導体等装置関連事業 – 26/3通期業績予想



## セグメント総括

- ▶ セラミックスが業績を牽引、石英の在庫影響は徐々に縮小する見通し
- ▶ 部品洗浄事業は堅調に推移、石英坩堝はPV向け売上減少も損益は改善

## 製品別詳細

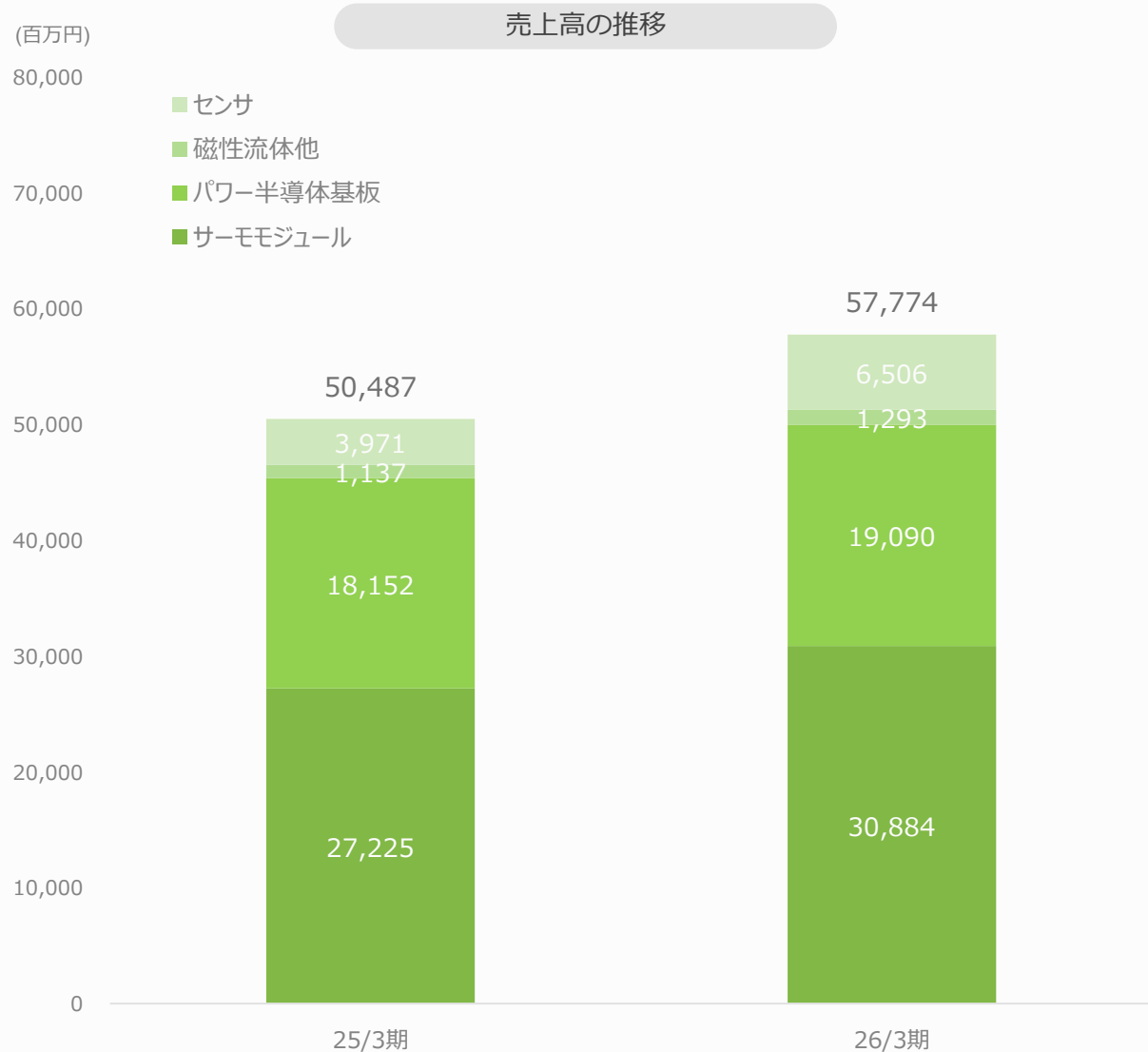
石英坩堝	市況悪化したPV向け縮小し半導体向けに注力、収益性が改善
再生ウェーハ	中国で拡大する需要取込みが順調に進捗、増進
装置部品洗浄	中国における需要が増勢、着実な需要取込みで成長
真空シール・金属加工	米国、中国の金属加工需要は堅調で引合い増加、成長継続

## 半導体材料

セラミックス	米国、中国の需要を着実に取込み増勢、グループ業績に貢献
CVD-SiC	特定の当社製品の需要が落込み、売上減少
シリコンパーツ	顧客在庫の影響等から売上軟調、コスト削減・収益改善中
石英製品	顧客在庫の影響は徐々に縮小する見通し、売上増加基調



# 電子デバイス事業 – 26/3通期業績予想



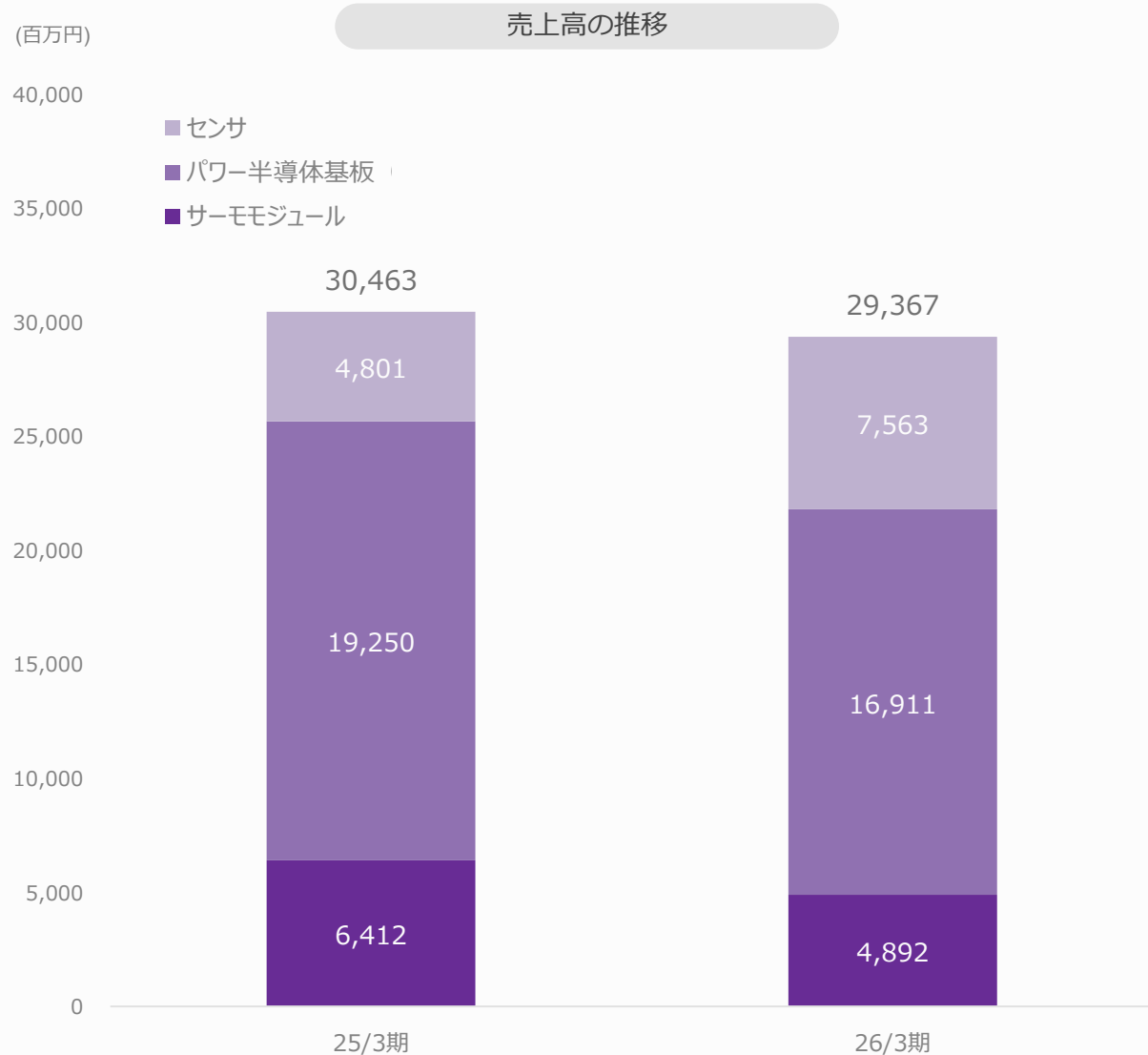
## セグメント総括

- ▶ 好調な生成AIサーバ投資を背景に、光トランシーバー向けが増加し、サーモモジュールの業績伸長、当社業績を牽引
- ▶ センサは大泉製作所の決算期変更により、前年度は1Qの売上計上がなく前期比で増加

## 製品別詳細

- |          |   |
|----------|---|
| サーモモジュール | ・ 生成AI需要を受け光トランシーバー向けの出荷が増加し業績伸長が継続、当社業績を牽引     |
| パワー半導体基板 | ・ 需要の伸び悩みや競争激化のなか、売上増加は確保できる見通しで通期予想を上方修正       |
| センサ      | ・ 大泉製作所の決算期変更により前年度1Q計上なく前期比で増加<br>・ エアコン向け等が貢献 |

# 車載関連事業 – 26/3通期業績予想



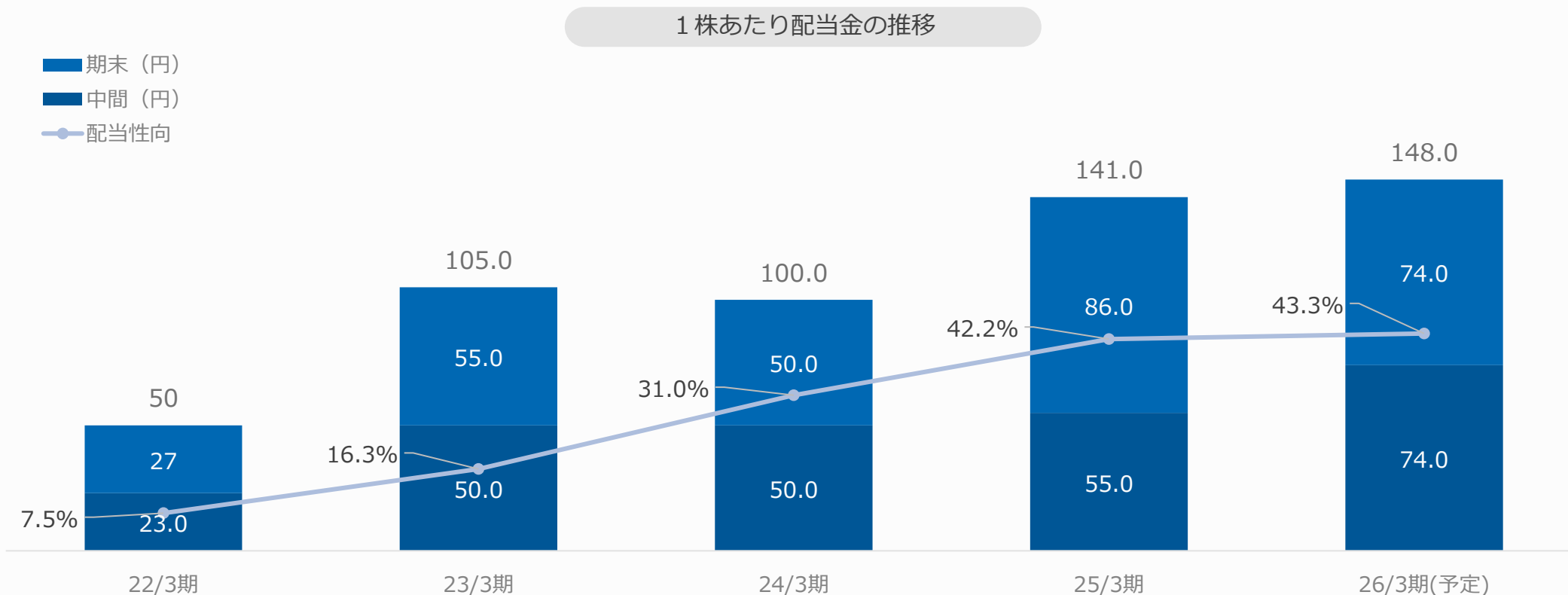
## セグメント総括

- ▶ EV需要の成長が鈍化、車載向けパワー半導体基板の売上は下振れ
- ▶ センサは大泉製作所の決算期変更により、前年度は1Qの売上計上がなく前期比で増加

## 製品別詳細

- |          |  |
|----------|--|
| サーモモジュール | ・ 市況悪化の影響もあり、車載向けTEの売上減少<br>前期比売上減少予想                    |
| パワー半導体基板 | ・ EV需要の成長が鈍化、需要低調の中で価格競争も激化<br>DCBおよびAMBとも苦戦し、売上は前期比減少予想 |
| センサ      | ・ 大泉製作所の決算期変更により前年度1Q計上なく<br>前期比で増加                      |

- ▶ 株主還元強化のため、DOEを採用し下限を3.5%に設定、総還元性向50%を目指す（既存方針から不変）
- ▶ 配当金は通期148円/株（配当性向43.3%）と予想



## 4. 中期経営計画

---



## ▶ 通期連結業績予想の修正を反映（太字箇所）

(百万円)		2025年3月期 実績	2026年3月期 予想	2027年3月期 計画	2028年3月期 計画
業績	売上高	274,390	285,000	340,000	400,000
	営業利益	24,089	<b>30,000</b>	35,000	47,000
	営業利益率	8.8%	<b>10.5%</b>	10.3%	11.8%
	当期純利益	15,692	16,000	20,000	29,000
資本効率	ROE	7.1%			15.0%
	ROIC※1	3.9%			8.0%
財務	自己資本比率	39.4%	40.0%	40.0%	40.0%
	設備投資額	51,777	65,000	45,000	30,000
株主還元	1株あたり配当金※2（年間）	141.0円	148.0円	DOE（連結株主資本配当率※2）を採用、下限を3.5%に設定 自社株式取得を機動的に検討、総還元性向50%を目指す	

※1 ROICは、親会社帰属純利益/(有利子負債+純資産) 但し純資産は新株予約権、非支配株主持分は除く

※2 連結株主資本=資本金+資本剰余金+利益剰余金-自己株式、連結株主資本配当率=配当金総額÷連結株主資本

## ▶ 2025年5月30日開示の中期経営計画から変更なし

### 事業成長

- ・ 半導体関連、電子デバイス、自動車関連事業を拡大し、成長を追求する
- ・ 米中摩擦による中国外製造（Ex-China)のニーズに対応してマレーシア等の中国外製造を強化しながら中国における半導体関連ニーズの取込みを進める

### 収益性向上 生産効率向上

- ・ マレーシア（クリム、ジョホール）工場の生産拡充・効率性向上による収益率の引上げ実現
- ・ デジタル化・自動化・AI化を展開し、生産効率向上・競争力強化を追求する
- ・ 新製品・新技術の開発を推進・強化、「品質は命」と考え品質管理の徹底を継続

### 人材強化 企業文化

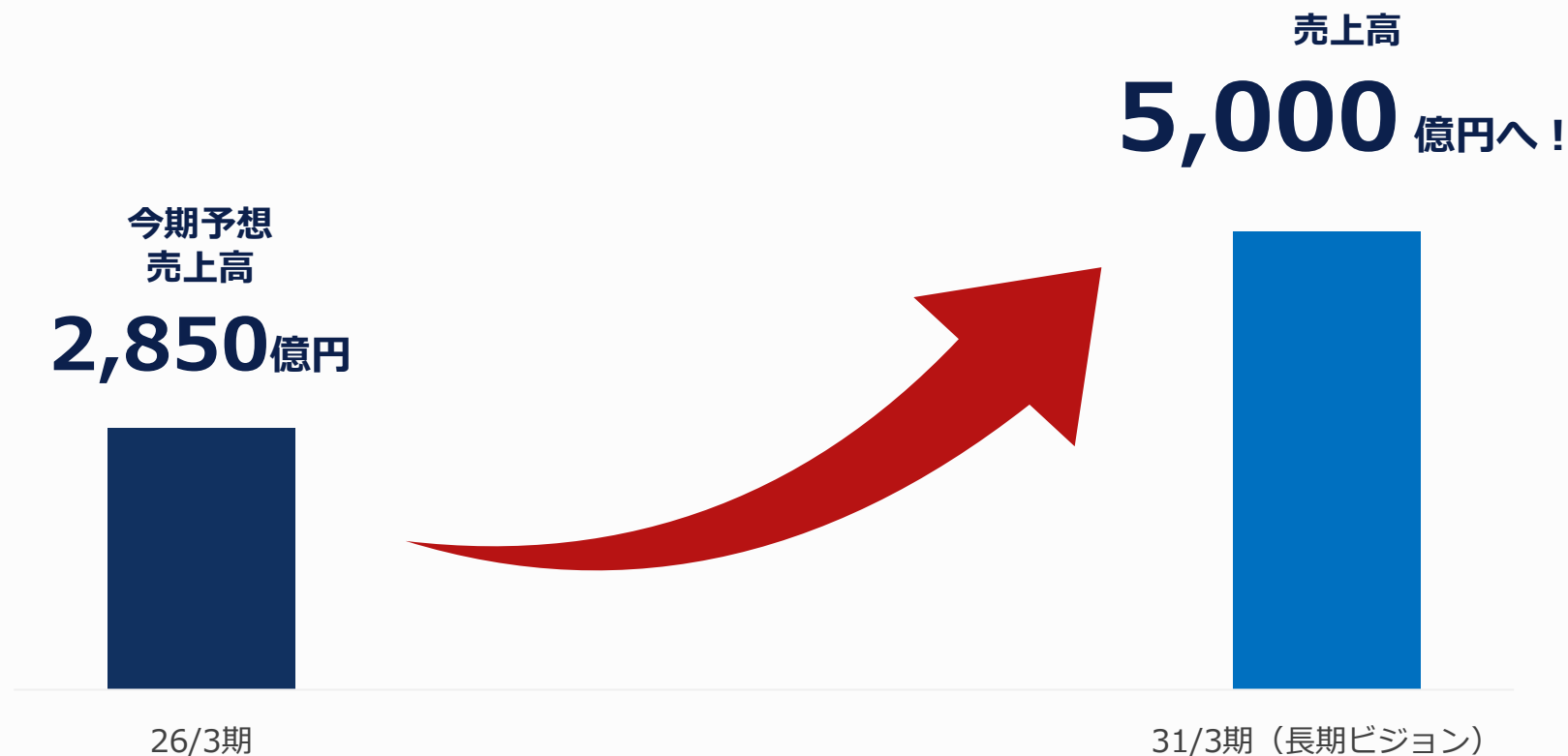
- ・ 人材重視を重要な経営戦略とし、人材の採用及び育成を推進
- ・ 企業文化は企業の礎であり、「顧客を尊敬、従業員を尊敬し、勤勉と信用を尊重し、着実に行動し、革新を追求する」指針の浸透活動を継続する

### 財務 株主還元

- ・ 中国上場の洗浄事業子会社FTSVAとパワー半導体基板子会社FLHの統合実現後には 株式時価が増加見通しであり、活用方法を検討する
- ・ 新たな株主還元方針に則り、DOEを採用。自社株式の取得も機動的に検討する方針

▶ 長期業績目標は継続も、キャッシュフロー及びROE・ROIC向上を図りながら実現を図る

2030年度に 売上高 **5,000**億円 当期純利益 **500**億円 の達成を目指す！



# Appendix

---

## 2026年3月期 上期実績および下期計画値

- ▶ 半導体装置関連事業の収益性改善などにより営業利益および経常利益を上方修正
- ▶ 上期の特別損失等を鑑み、親会社株主に帰属する当期純利益は据え置き

(百万円)	2026年3月期 上期		計画	2026年3月期 下期		増減額	増減率
	実績	売上比		売上比			
売上高	140,980	100.0%	144,019	100.0%		3,038	2.2%
売上総利益	40,780	28.9%	42,683	29.6%		1,902	4.7%
販売管理費	26,446	18.8%	27,016	18.8%		570	2.2%
営業利益	14,333	10.2%	15,667	10.9%		1,332	9.3%
経常利益	12,923	9.2%	15,076	10.5%		2,153	16.7%
当期純利益	6,308	4.5%	9,691	6.7%		3,382	53.6%

# 2026年3月期 上期実績および下期計画値 製品別売上高

(百万円)	2025年3月期 実績			2026年3月期 2Q					
	上期	下期	通期	上期（実績）	前年同期比	下期（予想）	前期比	通期（予想）	前年同期比
半導体等装置関連	84,042	81,202	165,245	88,378	5.2%	92,122	4.2%	180,500	17.3%
真空シール・金属加工	19,347	19,848	39,195	22,557	16.6%	29,274	29.8%	51,831	56.0%
石英製品	16,134	15,795	31,930	16,440	1.9%	16,500	0.4%	32,940	6.1%
シリコンパーツ	7,172	6,514	13,687	6,713	-6.4%	6,407	-4.6%	13,121	-8.4%
セラミックス	15,448	17,707	33,155	19,099	23.6%	19,100	0.0%	38,199	26.4%
CVD-SiC	3,992	4,199	8,192	4,639	16.2%	3,125	-32.6%	7,764	-9.2%
EBガン・LED蒸着装置他	4,076	4,166	8,242	3,932	-3.5%	2,103	-46.5%	6,036	-56.1%
ウエーハ加工（連結対象外）	10	0	10	-	-	-	-	-	-
再生ウエーハ	1,251	1,605	2,856	2,216	77.2%	2,581	16.5%	4,798	87.6%
装置部品洗浄	7,061	8,245	15,306	8,294	17.5%	8,832	6.5%	17,126	21.9%
石英坩堝	9,547	3,121	12,668	4,484	-53.0%	4,196	-6.4%	8,681	-88.9%
電子デバイス	23,085	27,401	50,487	28,090	21.7%	29,684	5.7%	57,774	25.9%
サーモモジュール	12,431	14,794	27,225	14,639	17.8%	16,244	11.0%	30,884	25.0%
パワー半導体基板	8,692	9,460	18,152	10,009	15.2%	9,080	-9.3%	19,090	9.4%
磁性流体他	575	562	1,137	616	7.2%	677	9.9%	1,293	25.3%
センサ	1,387	2,584	3,971	2,825	103.7%	3,681	30.3%	6,506	89.7%
車載関連	14,304	16,159	30,463	15,991	11.8%	13,376	-16.4%	29,367	-6.9%
サーモモジュール	3,108	3,304	6,412	2,639	-15.1%	2,253	-14.6%	4,892	-57.6%
パワー半導体基板	9,628	9,621	19,250	9,961	3.5%	6,949	-30.2%	16,911	-23.5%
センサ	1,567	3,233	4,801	3,390	116.2%	4,173	23.1%	7,563	81.5%
その他	13,723	14,470	28,194	8,520	-37.9%	8,836	3.7%	17,357	-127.2%
合計	135,157	139,233	274,390	140,980	4.3%	144,019	2.2%	285,000	7.5%



- ▶ 中国国務院（内閣）から認可を得て、証券法に基づいて設立された全国規模の店頭取引プラットフォームで全国中小企業株式譲渡システム有限会社が管理運営、中国証監会が監督、中国証券業協会が具体的な規則を制定している
- ▶ 新三板での取引は、機関投資家および適格投資家（プロ相当の個人投資家）を対象している

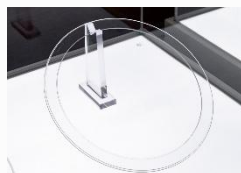
## 発行体の登録条件

- ・ 上場市場ほど厳しくはないが、ビジネスモデル、経営方針、コーポレートガバナンスなどの観点から、以下の6つの登録条件が定められている
- 1 設立から2年以上経った株式会社であること  
但し、有限会社が株式会社に転換した場合には、存続期間は有限会社の設立日から起算する
  - 2 業務が明確で、経営を持続する能力を有すること
  - 3 会社のガバナンスが健全で、法を順守した会社経営が行われていること
  - 4 株主の権利が明確で、株式の発行・流通が法律に違反していないこと
  - 5 スポンサー証券会社の推薦を得て持続的な監督・指導を受けていること
  - 6 全国株式譲渡システム運営会社（運営元）が要求する、その他の条件を満たしていること

## 新三板区分の「創新層」の登録条件

- ・ CCMCは新三板区分のうち「創新層」に登録された
  - ・ 創新層登録は以下条件のいずれかを満たす必要がありCCMCは# 3に該当
- 1 直近2年間の純利益がいずれも黒字であり、累計で800万元以上、または直近1年間の純利益が600万元以上であること
  - 2 直近2年間の売上高の平均が3,000万元以上であり、かつ直近1年間の売上高成長率が20%以上であるか、または直近2年間の売上高の平均が5,000万元以上で、営業活動によるキャッシュフローの純額がいずれもプラスであること
  - 3 直近1年間の売上高が3,000万元以上であり、直近2年間の研究開発投資の合計が、同期間の売上高の5%以上を占めていること
  - 4 直近2年間の研究開発投資の合計が1,000万元以上であり、直近24カ月間または上場と同時の定向増資で、専門機関投資家からの株式投資金額が2,000万元以上であること

## 半導体製造装置向け治具・消耗材（当社主力のマテリアル製品群）



石英



シリコンパーツ



セラミックス



CVD-SiC

当社製品群の強み： 設備投資連動型(真空シール)のみでなく、**半導体デバイスメーカーの生産稼働連動型リピート消耗材(マテリアル製品)**、サービス(洗浄・再生ウェーハ)をラインアップ



真空シール

※半導体・FPD  
製造装置部品



金属精密加工

※今後の中国国内顧客  
(工場) 増で伸長の見通し



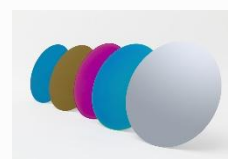
装置部品洗浄

※中国市場に特化



石英坩堝

※半導体・太陽電池向け



再生ウェーハ

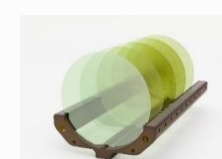
※中国市場に特化

## 持分法適用関連会社での事業



シリコンウェーハ

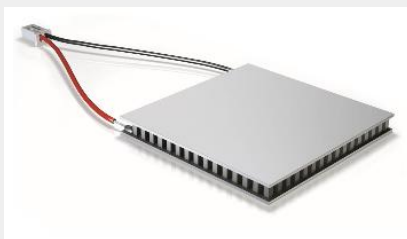
※月産能力6インチ 40万枚、  
8インチ 45万枚、12インチ30万枚



SiCウェーハ

※開発～量産化

## サーモモジュール



自動車・半導体製造装置・通信・医療バイオ・民生品など、温度調整デバイスとして用途が拡大中

## パワー半導体用絶縁基板



世界の消費電力削減のトレンドに対応し、パワー半導体顧客からの需要が拡大中（アルミナセラミックス基板に銅回路を接合する DIRECT COPPER BONDING技術）

## 磁性流体



自動車スピーカーや、高音質TVスピーカー、スマホのバイブレーション向けへの用途が拡大中



## チラー

チラー(恒温水循環装置)は、水などの循環する液体を予め設定した温度に冷却/加熱しながら供給する装置。設備や装置にある熱源などの対象物を一定の温度に保つことに用いられる

## パワー半導体のアプリケーション



## 温度センサ（サーミスタ）

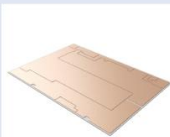
※大泉製作所

サーミスタは温度変化に対し、極めて大きな抵抗変化を示す半導体セラミックス。車載・家電・光通信などの温度センサとして幅広く使用され、車両電動化やデジタル化で需要拡大中

## 【主な製品】パワー半導体基板・アプリケーション

### DCB基板

主にルームランプやAV・アクセサリ制御などのインバーター向けに使用されるパワー半導体ユニットに搭載される基板です。材質はアルミナセラミックス材質の基板を提供しています。



### AMB基板

主にバッテリー制御やモーター制御などハイパワー用途で使用されます。窒化珪素・窒化アルミニウム材質で、主にSiC基板との組み合わせられる基板です。



## 【主な製品】サーミスタ・アプリケーション

### サーミスタ

サーミスタは温度変化に対し、極めて大きな抵抗変化を示す半導体セラミックスです。温度センサとして搭載され、エアコン、電池、燃料噴射など様々な制御を行うのに不可欠なパーツとなっています。



センサで世界を測る。未来を拓く。  
**OHIZUMI**



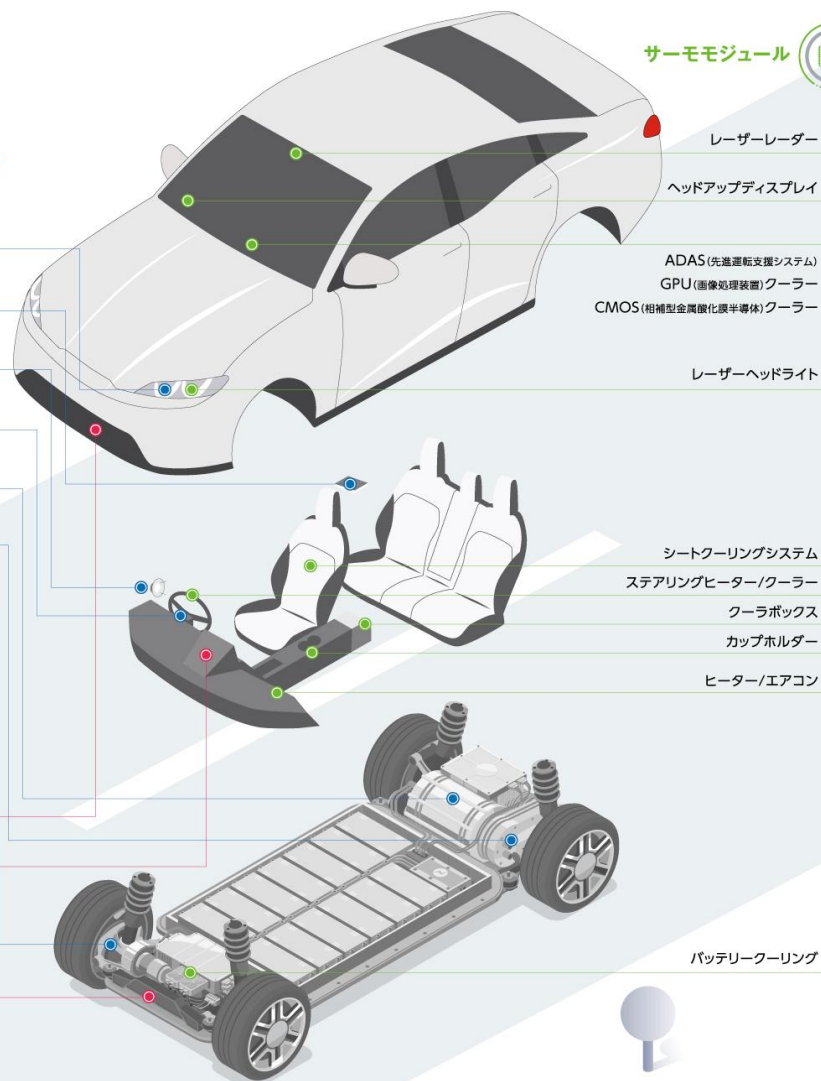
## パワー半導体

ヘッドランプ制御  
ルームランプ制御  
AV・アクセサリ制御  
ステアリング制御  
モータ制御  
トランスミッション制御  
ブレーキ制御



## サーミスタ

吸気エア量用  
吸気エア温用  
車内温度用  
ディーゼル燃温用  
ラジエーター水温用



## サーモジュール



## 【主な製品】サーモジュール・アプリケーション

### レーザーレーダー

レーザー光を対象物に照射して距離の計測や対象物の性質を特定します。サーモジュールを用いることで熱の影響を抑制し測定精度を安定させます。



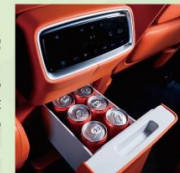
### 自動車用温調シート

運転席、助手席、後部座席シートを温めたり冷やしたりすることで、快適なドライブが可能になります。



### クーラボックス

EV車は比較的車内の居住空間を広く確保できるため、クーラボックスを搭載する車種が増えています。現在メーカーとの共同開発を進めています。



### カップホルダー

従来からあるカップホルダーも、サーモジュールを使用し、保温・保冷機能を持たせることで快適なドライブをサポートします。



- ▶ IRポータルサイト「IR STREET」にIRニュースを掲載・メール配信しております  
以下のQRコードもしくはリンクより、配信先メールアドレスをご登録いただけます

日本語



[登録ページリンクはこちら](#)

English



[Go to Registration Page](#)

- ▶ 本資料に掲載されている将来見通しの記述は、本資料の発表日現在において入手可能な情報及び将来の業績に影響を与える不確実な要因の仮定を前提としております。
- ▶ 実際の業績は、今後様々な要因によって大きく異なる可能性があります。業績に影響を与える要素には、国際情勢、経済情勢、製品の需給動向、原材料価額及び市況、為替レートなどが含まれますが、これに 限定されるものではありません。
- ▶ 本資料の数値は、百万円単位もしくは億円単位に端数処理をして記載しております。したがって、決算短信や有価証券報告書等の開示書類の数値と完全に一致しない場合がございます。
- ▶ 本資料中の定量目標などは、あくまで中長期的な戦略、ビジョン等を示すものであり業績予想ではありません。当社はこれらについて情報を更新する義務を負いません。
- ▶ 正式な業績予想は、東京証券取引所規則に基づく決算短信での開示をご参照ください。